

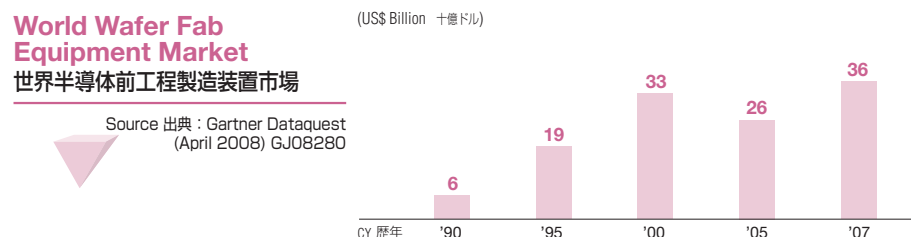
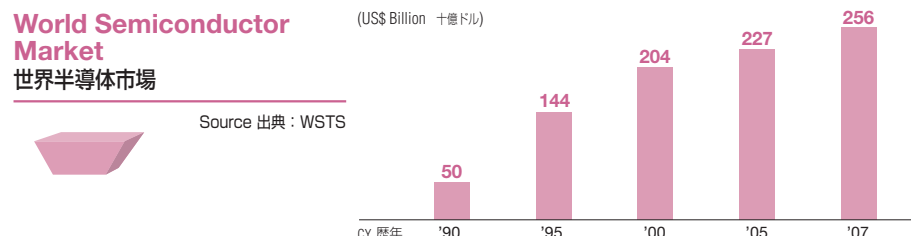
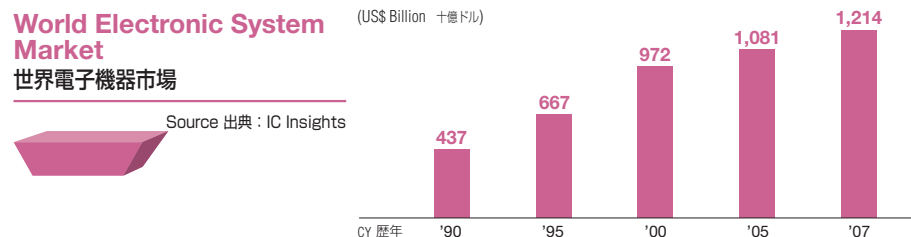
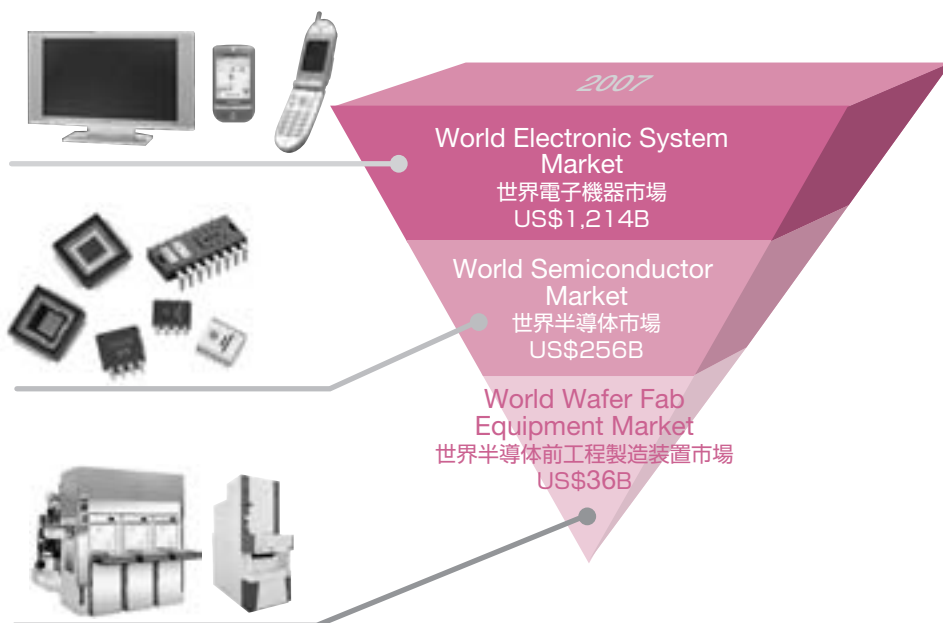
CONTENTS 目次

Industry Data	C2
インダストリー・データ	
Tokyo Electron (TEL) Overview	1
東京エレクトロン(TEL)の事業概要	
Global TEL	2
TELの世界展開	
Topics in Recent Years	3
近年のトピックス	
Semiconductor & TFT-LCD Manufacturing Process Flow	4
半導体製造工程及び TFT-LCD製造工程	
Consolidated Operating Results	6
連結業績	
Semiconductor Production Equipment (SPE) and FPD Production Equipment	8
半導体製造装置・FPD製造装置	
Consolidated Financial Data	10
連結財務データ	
Consolidated Balance Sheets	14
連結貸借対照表	
Consolidated Statements of Operations	16
連結損益計算書	
Consolidated Statements of Cash Flows	17
連結キャッシュ・フロー計算書	
Consolidated Quarterly Data	18
連結四半期データ	
Stock Information	20
株式情報	

TOKYO ELECTRON

2008 FACT BOOK

As of March 31, 2008



World TOP 10 Semiconductor Production Equipment Manufacturers 半導体製造装置メーカー世界トップ10

CY 1995	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Canon キヤノン
5	Lam Research ラム・リサーチ
6	Advantest アドバンテスト
7	Hitachi 日立
8	Teradyne テラダイン
9	Dainippon Screen 大日本スクリーン
10	Varian バリアン

CY 2000	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Teradyne テラダイン
5	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィ
6	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
7	Advantest アドバンテスト
8	Lam Research ラム・リサーチ
9	Canon キヤノン
10	Dainippon Screen 大日本スクリーン

CY 2005	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィ
4	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
5	Advantest アドバンテスト
6	Nikon ニコン
7	Lam Research ラム・リサーチ
8	Novellus Systems ノベラス システムズ
9	Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ
10	Canon キヤノン

CY 2007	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィ
4	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
5	Lam Research ラム・リサーチ
6	Nikon ニコン
7	Advantest アドバンテスト
8	Novellus Systems ノベラス システムズ
9	Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ
10	Dainippon Screen 大日本スクリーン

Source 出典: VLSI Research

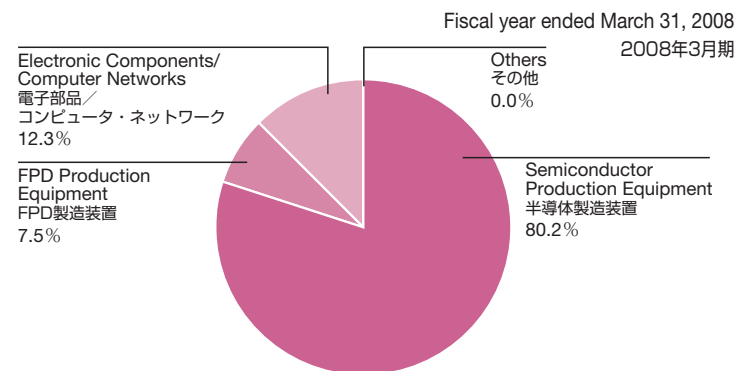
Corporate Information

会社概要

<p>Corporate Name 商号</p> <p>World Headquarters 本社所在地</p> <p>Established 設立</p> <p>Capital 資本金</p>	<p>Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社</p> <p>Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー</p> <p>November 11, 1963 1963年11月11日</p> <p>¥54.9 Billion (as of March 31, 2008) 549億円 (2008年3月31日現在)</p>
---	---

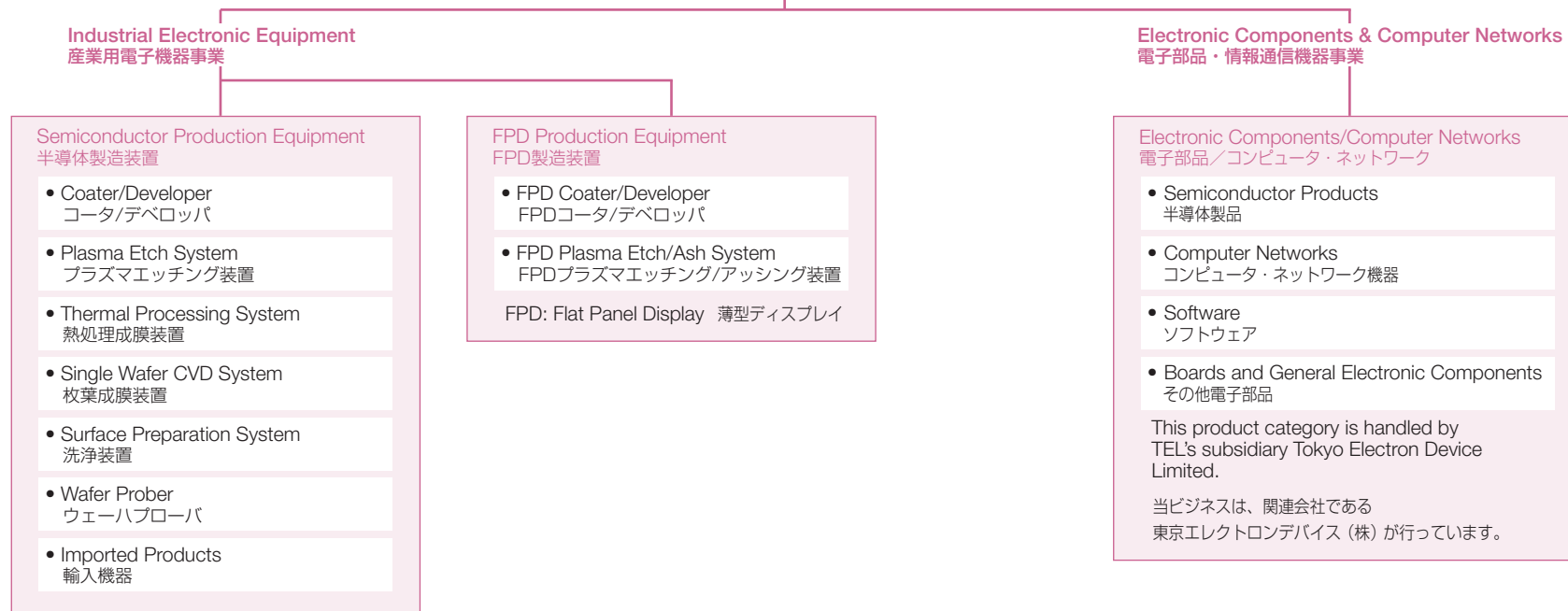
Composition of Net Sales by Division

部門別売上構成比



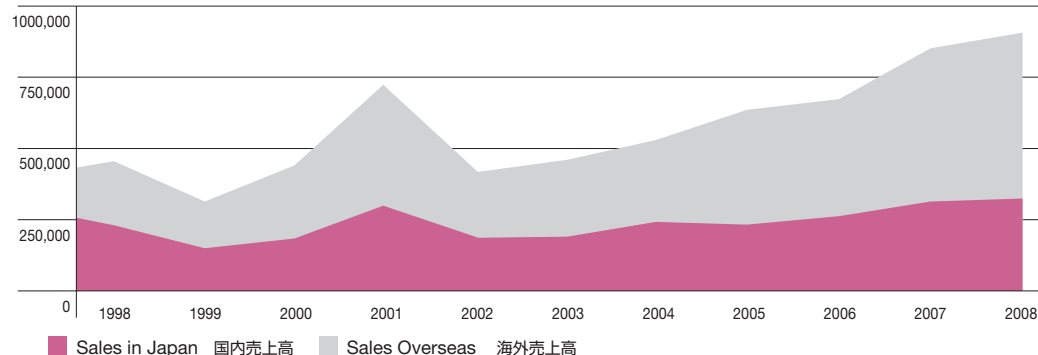
Major Products and Services
主要取扱製品

As of April 2008 (2008年4月現在)



Consolidated Sales in Japan and Overseas

連結国内・海外売上高推移

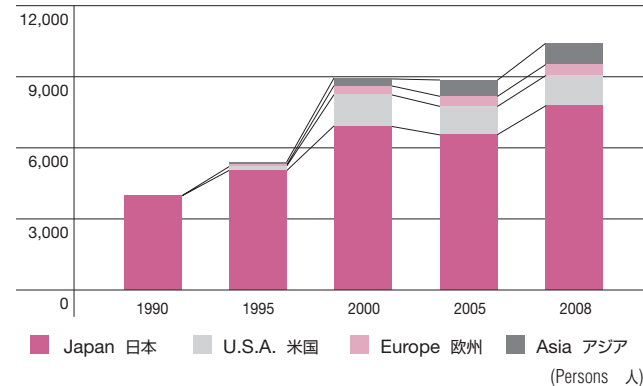


FY 年度	Sales (Sales in Japan 国内売上高 / Sales Overseas 海外売上高)										
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sales in Japan 国内売上高	230,550	149,838	183,987	299,272	186,516	190,513	242,318	232,678	262,532	313,816	323,946
Sales overseas 海外売上高	225,035	163,982	256,742	424,608	231,309	270,067	287,336	403,032	411,154	538,159	582,146
Total 合計	455,585	313,820	440,729	723,880	417,825	460,580	529,654	635,710	673,686	851,975	906,092

(¥ Millions 百万円)

Number of Employees Worldwide

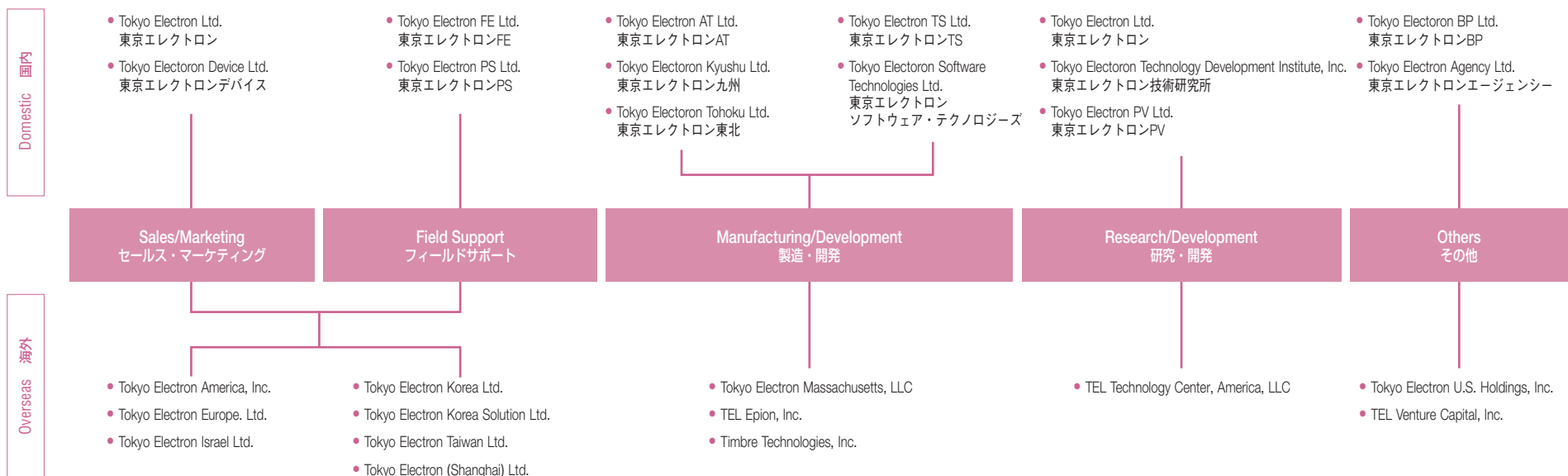
ワールドワイド人員推移



FY 年度	Employees (Persons 人)				
	1990	1995	2000	2005	2008
Japan 日本	3,980	5,041	6,922	6,548	7,789
U.S.A. 米国	8	192	1,315	1,205	1,281
Europe 欧州	0	51	378	425	450
Asia アジア	0	126	331	686	909
Total 合計	3,988	5,410	8,946	8,864	10,429

Tokyo Electron Group 東京エレクトロングループ

As of June 1, 2008 (2008年6月1日現在)



1998 **2月**
Feb Construction of a new facility at the Process Technology Center capable of handling 300mm wafer was completed in Hosaka, Yamanashi Prefecture.
山梨穂坂地区に300mmウェーハ対応プロセステクノロジーセンター新棟が完成

1999 **10月**
Oct TEL's sector classification in the First Section of the Tokyo Stock Exchange was changed from "Wholesale Trade" to "Electric Appliances".
東証第1部における業種を「商業」から「電気機器」へ変更

2000 **8月**
Aug The trading unit for TEL stock was changed from 1,000 shares to 100 shares.
1単位の株式数を1,000株から100株に変更

2001 **2月**
Feb TEL acquired a stake in Timbre Technologies, Inc., a leader in advanced metrology.
最先端の計測ソフトウェア技術を有する米国 Timbre Technologies, Inc.を買収し子会社にする

2002 **4月**
Apr Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. established.
東京エレクトロン上海（株）を設立

11月
Nov TEL participated in Albany NanoTech project promoted by New York State.
ニューヨーク州が推進する研究開発推進支援プログラム「アルバニー・ナノテック」プロジェクトへ参加

2003 **3月**
Mar Tokyo Electron Device Ltd. listed on the 2nd Section of the Tokyo Stock Exchange.
東京エレクトロンデバイス（株）東京証券取引所第2部に上場

8月
Aug TEL Technology Center, America, LLC (TTCA) established in the U.S. to conduct research and development of cutting-edge semiconductor materials and processes.
米国に先進的な半導体材料およびプロセスの研究を行うTEL Technology Center, America, LLC (TTCA)を設立

2004 **4月**
Apr Tokyo Electron AT Ltd. (surviving company) and Tokyo Electron Tohoku Ltd., manufacturing subsidiaries in Japan, merged.
国内製造拠点、東京エレクトロンAT（株）（存続会社）と東京エレクトロン東北（株）が合併

7月
Jul Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. established in the U.S. It controls Tokyo Electron America, Tokyo Electron Massachusetts and TEL Technology Center, America.
米国に持株会社Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc.を設立。米国内現地法人Tokyo Electron America, Tokyo Electron Massachusetts, TEL Technology Center, Americaを傘下に入れる。

2005 **1月**
Jan TEL received the Superior Corporate Disclosure Award from the Tokyo Stock Exchange for the second time, the first time being in 1999.
東証より、1999年に引き続き2度目の「ディスクロージャー優良企業」に選定され、受賞

2006 **2月**
Feb Tokyo Electron Korea Solution Ltd. established.
東京エレクトロンコリアソリューション（株）を設立

4月
Apr Tokyo Electron AT was split into three- Tokyo Electron At Ltd., Tokyo Electron Tohoku Ltd. and Tokyo Electron TS Ltd.
東京エレクトロンAT（株）を分割し、東京エレクトロンAT（株）、東京エレクトロン東北（株）、東京エレクトロンTS（株）を設立

6月
Jun TEL Venture Capital, Inc. established
米国にTEL Venture Capital, Inc.を設立

12月
Dec TEL acquired Epion Corporation, a supplier of gas cluster ion beam technology.
ガスクラスタイオンビーム技術を有する米国・エピオン社を買収

2007 **2月**
Feb Tokyo Electron PS Ltd. established.
ポストセールス専門のエンジニアリング会社・東京エレクトロンPS（株）を設立

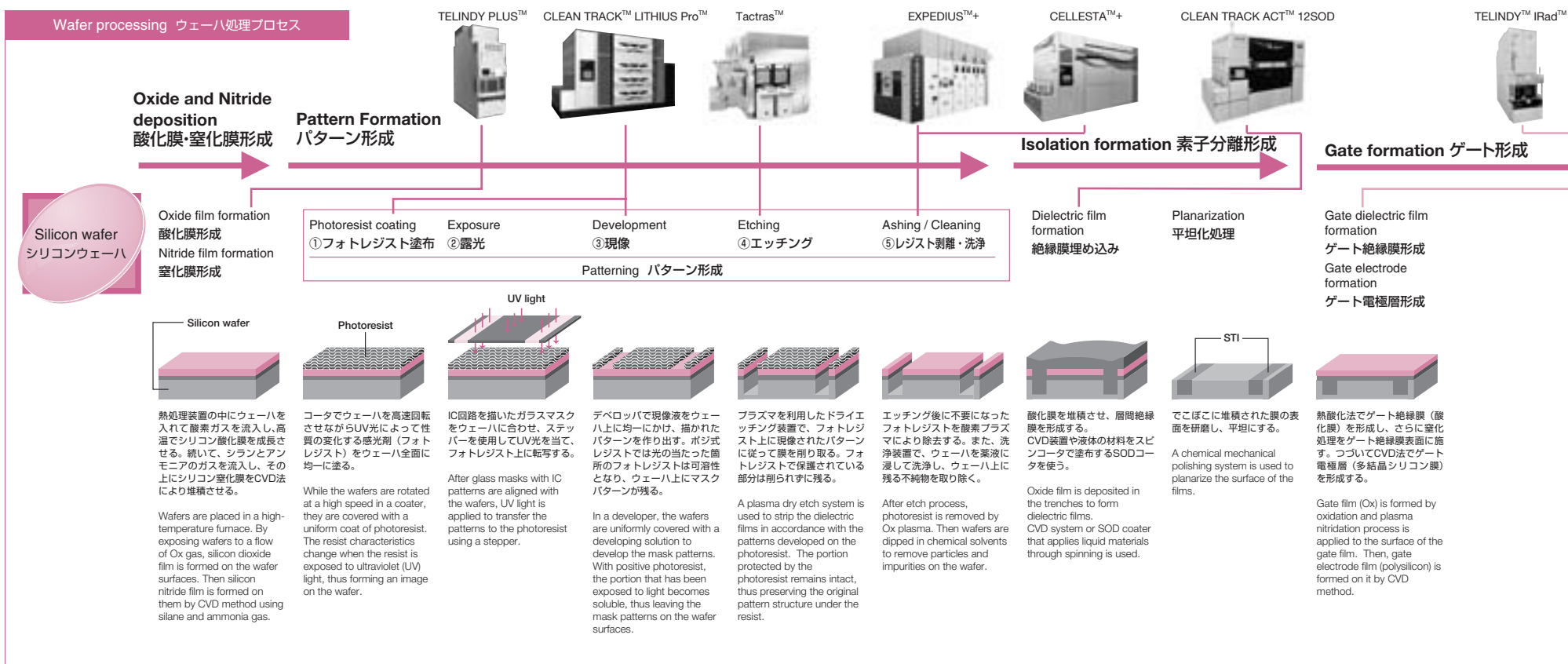
6月
Jun RLSA Division spun off and Tokyo Electron Technology Development Institute, Inc. established.
RLSA事業部門を分社化し、東京エレクトロン技術研究所（株）を設立

11月
Nov TEL joined leading chip-makers in SEMATECH's 3D Interconnect Program.
SEMATECH三次元積層プログラムに参加

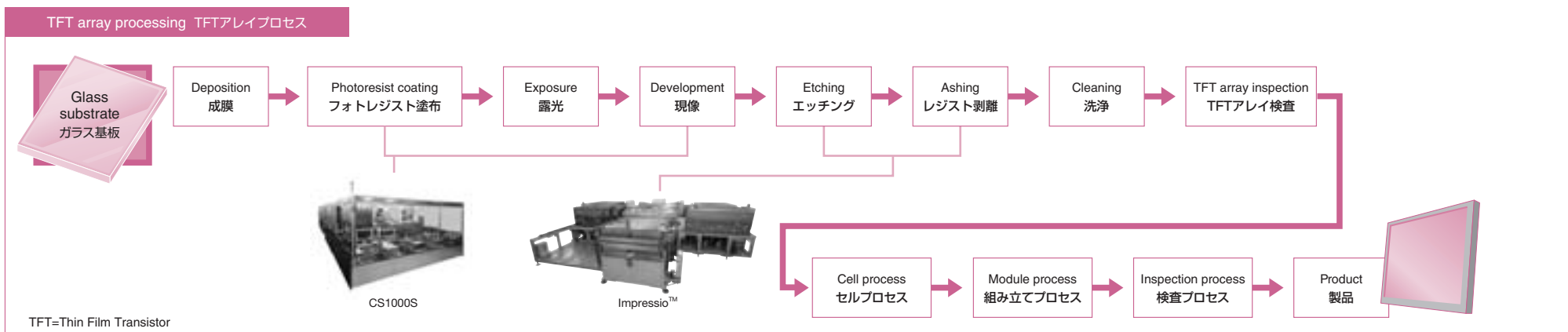
2008 **2月**
Feb TEL entered the photovoltaic cell production equipment business.
薄膜シリコン型太陽電池用製造装置事業に参入

The fabrication processes (wafer processing and TFT array process) essential for manufacturing semiconductors and TFT-LCDs are similar.
半導体やTFT-LCD製造の要となる前工程（ウェーハ処理プロセス、TFTアレイプロセス）は、ともによく似た工程です。

Semiconductor manufacturing process 半導体製造プロセス



TFT-LCD manufacturing process TFT-LCD製造プロセス



TELFORMULA™ Trias™ SPA / Trias™ High-k CVD



Trias™



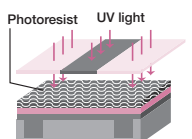
Precio™



**Interconnect formation
配線形成**

**Wafer test
ウェーハ検査**

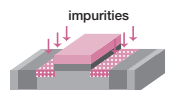
**Patterning
パターン形成**



ゲート電極層上にパターン形成プロセスを施し、ソース・ドレイン領域をつくる。

Source and drain areas are made by applying patterning processes to the gate electrode layer.

**Ion implantation
イオン注入
Annealing
アニール**



ソース・ドレイン領域にイオン注入法で導入した元素（ホウ素や砒素等）を打ち込む。酸化膜が残っている部分にはイオンが注入されない。その後、高温アニールによって不純物を均一に拡散させる。

An ion implanter dopes the source and drain areas with impurities, such as boron and arsenic. Ox films prevent dopant ions from being implanted in other areas. Subsequent annealing diffuses these impurities to a more uniform density.

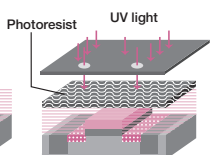
**Intermetal dielectric film formation
層間絶縁膜形成
Planarization
平坦化処理**



酸化膜をCVD法で堆積させ層間絶縁膜を形成し、表面を研磨して平坦にする。

Intermetal dielectric film is formed by oxide using CVD method and the film surface is planarized by polishing system subsequently.

**Patterning
パターン形成**



絶縁膜上にパターン形成プロセスを施し、コンタクトホールを開く。

Contact holes are opened by applying patterning processes to the dielectric film surface.

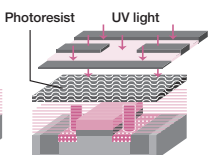
**Contact formation
コンタクト形成**



CVD法で金属膜を埋め込む。余分な膜は研磨で除去する。

The holes are filled with metal film by CVD, then excess metal is removed by polishing.

**Patterning
パターン形成**



低誘電率膜等の層間絶縁膜を堆積する。次にパターン形成を行い配線となる部分（トレンチ）を開く。

Low-dielectric-constant film is deposited followed by trench formation in the film by patterning process.

**Interconnect formation
配線形成**



トレンチに金属膜を埋め込み余分な膜を研磨し除去する。

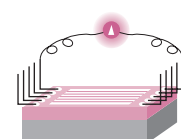
Metal films are filled into the trench and excess metals are polished.

**Interconnect formation
配線形成**



層間絶縁膜堆積～金属膜埋め込み/研磨の一連のプロセスを必要な配線層数分繰り返す

Processes from dielectric film formation to metal polishing are repeated to make a multi level interconnect.



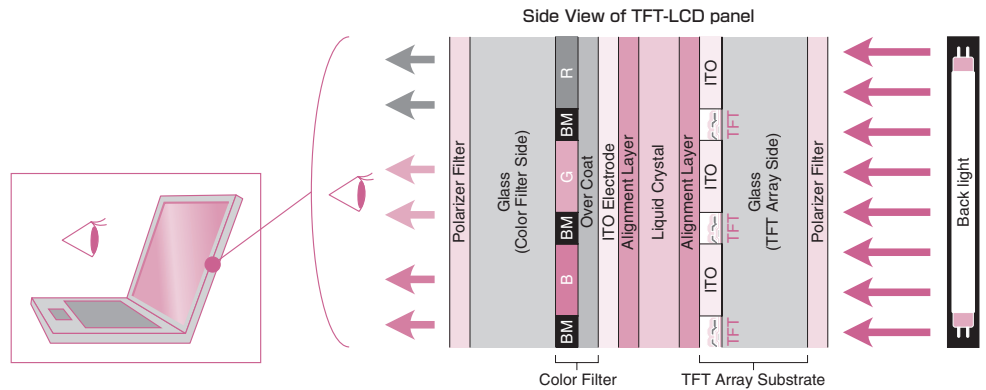
でき上がったウェーハには同じLSIチップが数百個作られている。プローバで1つ1つのチップにプローブ針を接触させ、つないだデスターと信号のやりとりをしながらチップの良・不良を電氣的に検査する。

There are several hundreds of identical LSI chips on a fabricated wafer. Prober makes pins contact chips, and tests whether chips are good or bad electrically by exchanging signals.

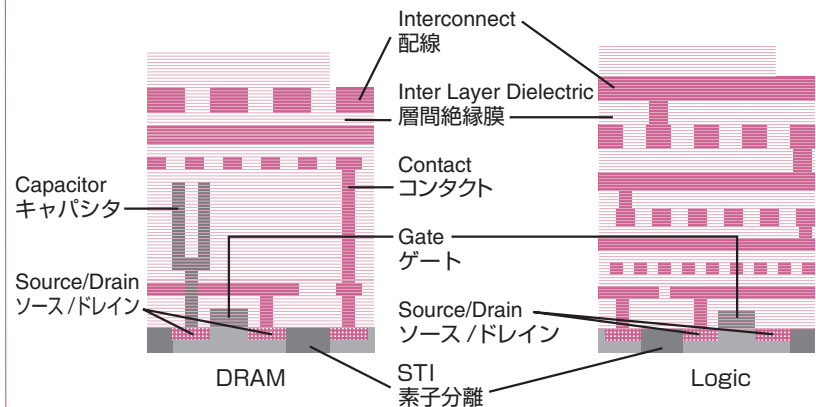
Assembly process
組立プロセス

Inspection process
検査プロセス

Product
製品

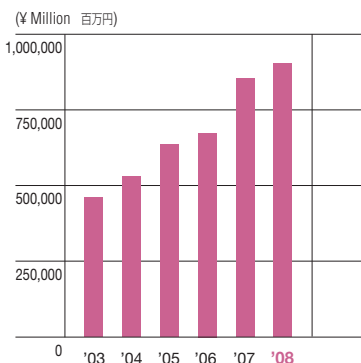


Cross section 断面図

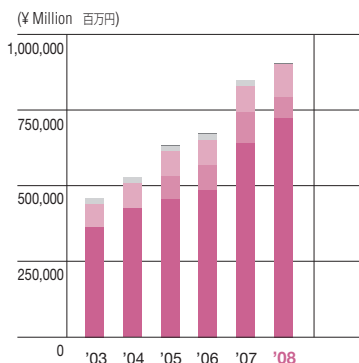


TEL's fiscal year ends on March 31. Each fiscal year described in this document is identified by the year in which it ends. For example, FY2008 is the fiscal year ended March 31, 2008. 当社は3月31日を決算日としています。本誌記載の年度は各営業期間の終了した会計年度です。例えば、FY2008は2008年3月31日に終了した会計年度です。

Net Sales 売上高



Net Sales by Division 部門別売上高

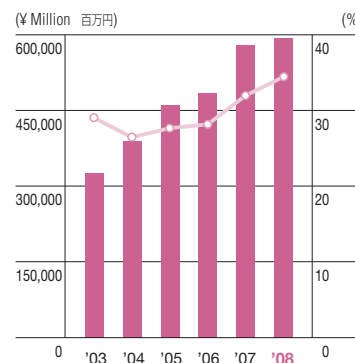


■ Semiconductor production equipment 半導体製造装置
■ FPD production equipment FPD製造装置
■ Electronic components 電子部品
■ Computer networks コンピュータ・ネットワーク
■ Others その他

Composition of Net Sales by Division 部門別売上構成比

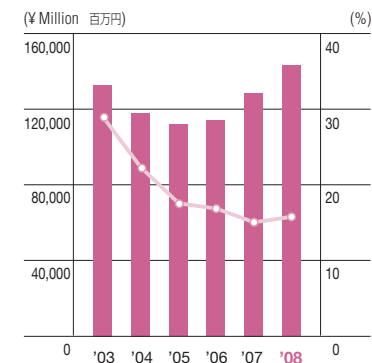


Cost of Sales and Gross Profit Margin 売上原価及び売上総利益率



■ Cost of sales 売上原価
○ Gross profit margin 売上総利益率

Selling, General and Administrative Expenses and Ratio to Net Sales 販売費及び一般管理費及び対売上高比率



■ SG&A expenses 販売費及び一般管理費
○ SG&A expenses ratio 販管費率

Electronic Components & Computer Networks reclassified from FY2008
2008年3月期より電子部品・情報通信機器

FY 年度	Net sales (¥ Million)		Cost of Sales (¥ Million)					Gross Profit Margin (%)	
	売上高	(% of total) 構成比	Semiconductor production equipment 半導体製造装置	FPD production equipment FPD製造装置	Electronic components 電子部品	Computer networks コンピュータ・ネットワーク	Other その他	売上原価	売上総利益率
2003	460,580	(100.0)	364,689 (79.2)	—	77,380 (16.8)	17,193 (3.7)	1,318 (0.3)	326,540	29.1
2004	529,654	(100.0)	425,747 (80.4)	—	84,229 (15.9)	18,448 (3.5)	1,230 (0.2)	389,499	26.5
2005	635,710	(100.0)	457,191 (71.9)	75,038 (11.8)	86,249 (13.6)	15,966 (2.5)	1,266 (0.2)	459,797	27.7
2006	673,686	(100.0)	486,883 (72.3)	81,176 (12.0)	86,881 (12.9)	17,497 (2.6)	1,249 (0.2)	483,954	28.2
2007	851,975	(100.0)	642,625 (75.4)	100,767 (11.8)	88,294 (10.4)	19,169 (2.2)	1,121 (0.2)	579,326	32.0
2008	906,092	(100.0)	726,440 (80.2)	68,016 (7.5)	111,181 (12.3)	455 (0.0)		594,794	34.4

Sales by division represents the sales to customers.
部門別売上高は、外部顧客に対する売上高です。

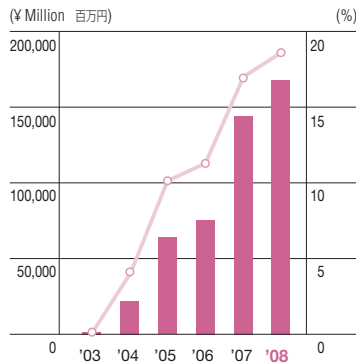
FY 年度	SG&A expenses (¥ Million)		Ratio to net sales (%)	
	販売費及び一般管理費	対売上高比率	Ratio to net sales	対売上高比率
2003	132,921	28.9		
2004	117,875	22.3		
2005	111,930	17.6		
2006	114,029	16.9		
2007	128,671	15.1		
2008	142,800	15.8		

Notes: 1. Some of the field engineering expenses of service-related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.
2. From FY2005, sales of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis.
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
4. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
5. From FY2008, sales of "Electronic components" and "Computer networks", which were disclosed separately, are combined as "Electronic Components & Computer Networks".

注) 1. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しました。
2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高に含めていたFPD製造装置の売上高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
4. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
5. 2008年3月期より、従来電子部品およびコンピュータ・ネットワークで個別に開示していた売上高を、電子部品・情報通信機器として開示しています。

Operating Income (Loss) and Operating Margin

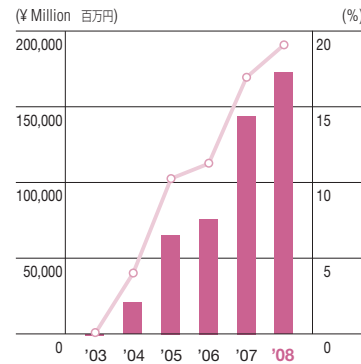
営業損益及び営業利益率



■ Operating income (loss) 営業損益
○ Operating margin 営業利益率

Ordinary Income (Loss) and Ordinary Profit Margin

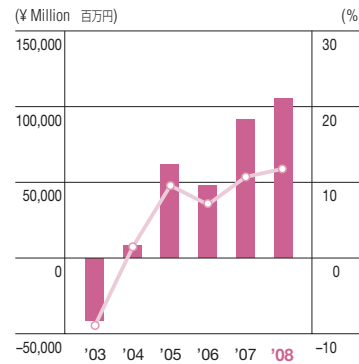
経常損益及び経常利益率



■ Ordinary income (loss) 経常損益
○ Ordinary profit margin 経常利益率

Net Income (Loss) and Net Income Margin

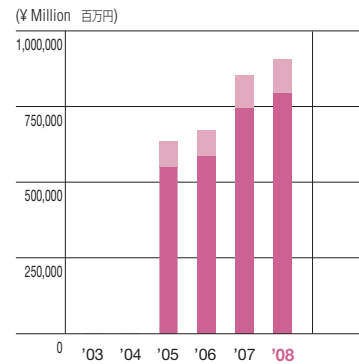
当期損益及び当期利益率



■ Net income (loss) 当期損益
○ Net income margin 当期利益率

Net Sales by Business Segment

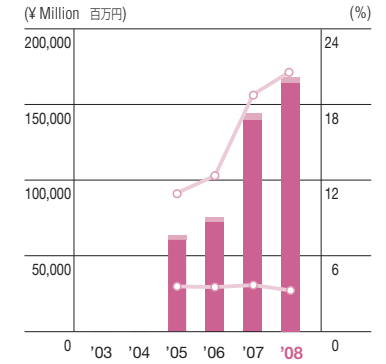
セグメント別売上高



■ Industrial electronic equipment 産業用電子機器事業
■ Electronic components & Computer networks 電子部品・情報通信機器事業

Operating Income and Operating Margin by Business Segment

セグメント別営業利益・営業利益率



■ Industrial electronic equipment 産業用電子機器事業
■ Electronic components & Computer networks 電子部品事業・情報通信機器事業
○ Operating margin 営業利益率

FY	Operating income (loss) (¥ Million)	Operating margin (%)
年度	営業損益	営業利益率
2003	1,119	0.2
2004	22,280	4.2
2005	63,983	10.1
2006	75,703	11.2
2007	143,979	16.9
2008	168,498	18.6

FY	Ordinary income (loss) (¥ Million)	Ordinary profit margin (%)
年度	経常損益	経常利益率
2003	(230)	(0.0)
2004	21,167	4.0
2005	65,633	10.3
2006	75,952	11.3
2007	143,941	16.9
2008	172,713	19.1

FY	Net income (loss) (¥ Million)	Net income margin (%)
年度	当期損益	当期利益率
2003	(41,554)	(9.0)
2004	8,297	1.6
2005	61,601	9.7
2006	48,006	7.1
2007	91,263	10.7
2008	106,271	11.7

FY	Industrial electronic equipment & Computer networks (¥ Million)		Electronic components & Computer networks (¥ Million)	
	Industrial electronic equipment	Electronic components & Computer networks	Electronic components & Computer networks	Industrial electronic equipment
年度	産業用電子機器事業	電子部品・情報通信機器事業	電子部品・情報通信機器事業	産業用電子機器事業
2003	—	—	—	—
2004	—	—	—	—
2005	550,514	88,080	88,080	(13.8)
2006	587,809	88,290	88,290	(13.1)
2007	746,894	108,710	108,710	(12.7)
2008	796,028	112,129	112,129	(12.3)

FY	Industrial electronic equipment (¥ Million)		Electronic components & Computer networks (¥ Million)	
	Operating income	Operating margin (%)	Operating income	Operating margin (%)
年度	営業利益	営業利益率 (%)	営業利益	営業利益率 (%)
2003	—	—	—	—
2004	—	—	—	—
2005	60,790	11.0	3,107	3.5
2006	72,568	12.3	3,100	3.5
2007	140,354	18.8	3,970	3.7
2008	164,808	20.7	3,659	3.3

*1 : Semiconductor production equipment, FPD production equipment, Other 半導体製造装置、FPD製造装置、その他

*2 : Electronic components, Computer networks 電子部品、コンピュータ・ネットワーク

Sales of Computer networks were included in segment " *1 " before FY2006 コンピュータ・ネットワークは、2006年3月期以前は*1に含まれます。

Sales include inter-segment transactions. 売上高は、セグメント間取引を含んでいます。

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:

(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".

3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

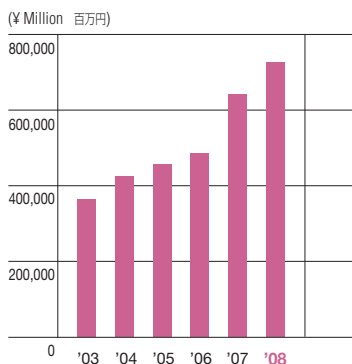
注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。

3. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

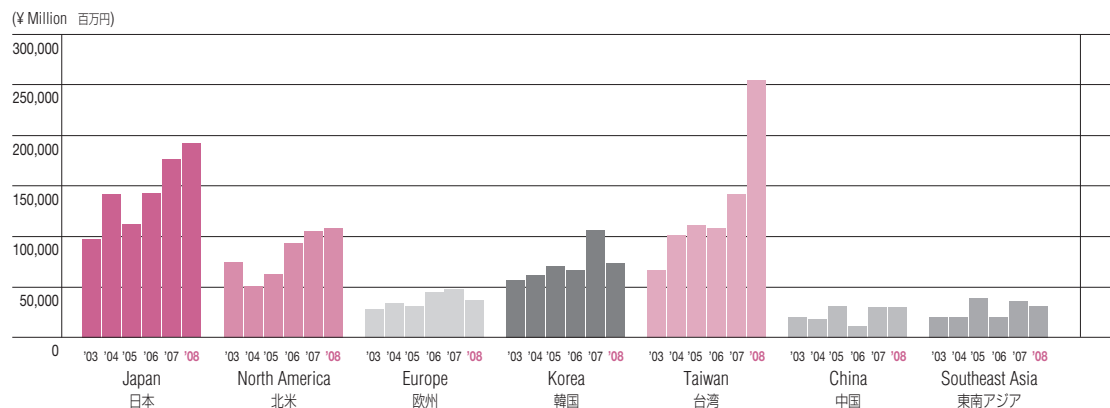
SPE Sales

半導体製造装置売上高



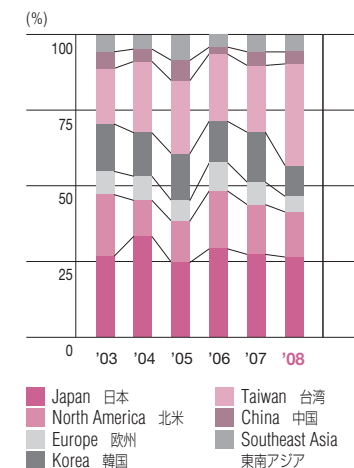
SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上高



Composition of SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上構成比



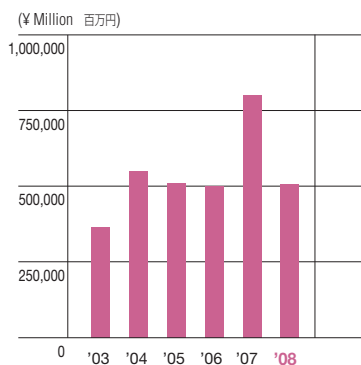
FY	SPE Sales
2003	364,689
2004	425,747
2005	457,191
2006	486,883
2007	642,625
2008	726,440

FY	Japan	North America	Europe	Korea	Taiwan	China	Southeast Asia	Total
2003	97,429 (26.7)	74,294 (20.4)	27,979 (7.7)	57,304 (15.7)	66,998 (18.4)	20,116 (5.5)	20,569 (5.6)	364,689 (100.0)
2004	141,916 (33.3)	50,622 (11.9)	33,896 (8.0)	61,412 (14.4)	100,455 (23.6)	17,558 (4.1)	19,888 (4.7)	425,747 (100.0)
2005	112,455 (24.6)	62,725 (13.7)	31,127 (6.8)	71,052 (15.5)	110,646 (24.2)	30,669 (6.7)	38,517 (8.5)	457,191 (100.0)
2006	142,174 (29.2)	93,272 (19.2)	45,045 (9.3)	66,948 (13.8)	108,314 (22.2)	10,830 (2.2)	20,300 (4.1)	486,883 (100.0)
2007	175,731 (27.3)	105,614 (16.4)	47,964 (7.5)	106,169 (16.5)	141,794 (22.1)	29,651 (4.6)	35,702 (5.6)	642,625 (100.0)
2008	191,935 (26.4)	108,708 (15.0)	36,929 (5.1)	73,212 (10.1)	254,973 (35.1)	29,864 (4.1)	30,819 (4.2)	726,440 (100.0)

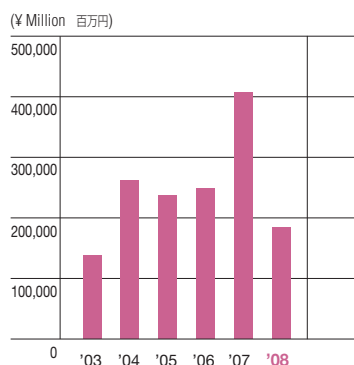
- Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.
 2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.
 3. Geographical sales are classified according to sales destinations.

- 注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含んでいたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を含めて表示しています。
 3. 地域別売上高は、販売先の所在地に基づいています。

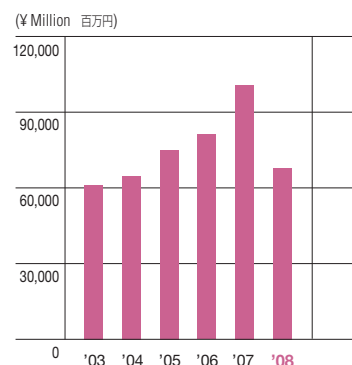
SPE Orders Received 半導体製造装置受注高



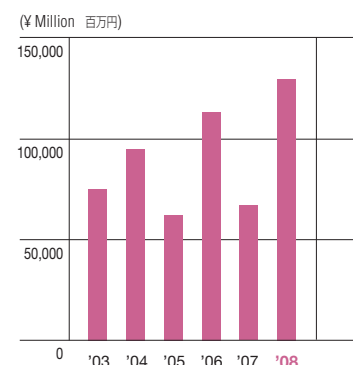
SPE Order Backlog 半導体製造装置受注残高



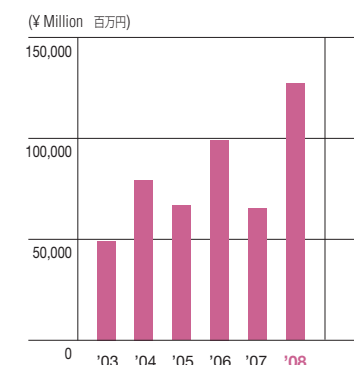
FPD Production Equipment Sales FPD製造装置売上高



FPD Production Equipment Orders Received FPD製造装置受注高



FPD Production Equipment Order Backlog FPD製造装置受注残高



FY	SPE orders received
2003	363,413
2004	549,774
2005	510,537
2006	499,863
2007	800,435
2008	504,116

FY	SPE order backlog
2003	138,314
2004	262,340
2005	236,179
2006	249,159
2007	406,969
2008	184,646

FY	FPD production equipment sales
2003	61,100
2004	64,770
	Consolidated
2005	75,038
2006	81,176
2007	100,767
2008	68,016

FY	FPD production equipment orders received
2003	75,017
2004	95,030
	Consolidated
2005	62,283
2006	113,494
2007	66,908
2008	129,907

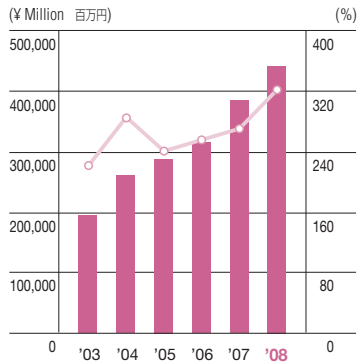
FY	FPD production equipment order backlog
2003	49,232
2004	79,493
	Consolidated
2005	66,752
2006	99,069
2007	65,211
2008	127,102

Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.
2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を含めて表示しています。

Working Capital and Current Ratio

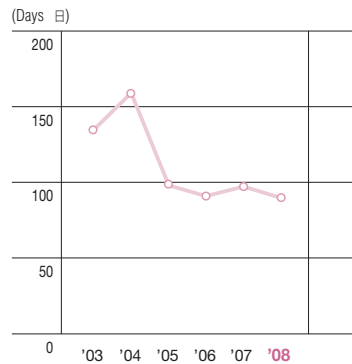
運転資本及び流動比率



■ Working capital 運転資本
○ Current ratio 流動比率

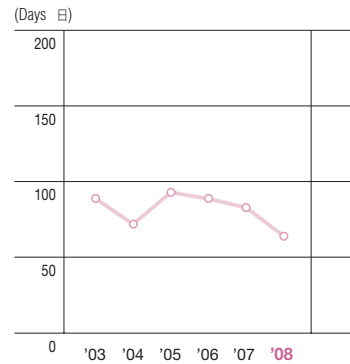
Receivable Turnover

売上債権回転日数



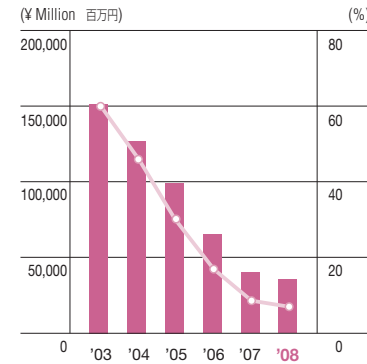
Inventory Turnover

たな卸資産回転日数



Interest-Bearing Debt and Debt-to-Equity Ratio

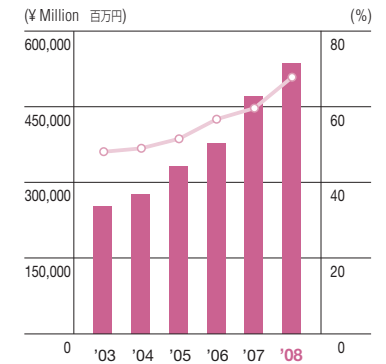
有利子負債及びデット・エクイティ・レシオ



■ Interest-bearing debt 有利子負債
○ Debt-to-equity ratio デット・エクイティ・レシオ

Equity and Equity Ratio

自己資本及び自己資本比率



■ Equity 自己資本
○ Equity ratio 自己資本比率

FY	Working capital (¥ Million)	Current ratio (%)
2003	195,733	221.8
2004	261,502	284.8
2005	288,575	239.7
2006	315,861	256.7
2007	384,508	270.2
2008	441,413	322.0

FY	Receivable turnover (Days)
2003	135
2004	159
2005	99
2006	92
2007	98
2008	90

FY	Inventory turnover (Days)
2003	89
2004	72
2005	93
2006	89
2007	83
2008	65

FY	Interest-bearing debt (¥ Million)	Debt-to-equity ratio (%)
2003	151,362	59.8
2004	127,045	46.1
2005	99,451	29.9
2006	65,100	17.3
2007	40,212	8.7
2008	36,070	6.7

FY	Equity (¥ Million)	Equity ratio (%)
2003	252,904	48.2
2004	275,800	49.1
2005	332,165	51.6
2006	376,900	56.8
2007	460,175	59.7
2008	534,954	67.5

Working capital = Current assets – Current liabilities
 運転資本 = 流動資産 – 流動負債
 Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100
 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)

Receivable turnover = Trade notes and accounts receivable at fiscal year-end / Net sales × 365
 売上債権回転日数 = 期末受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 365

Inventory turnover = Inventories at fiscal year-end / Net sales × 365
 たな卸資産回転日数 = 期末たな卸資産 ÷ 売上高 × 365

Debt-to-equity ratio = Interest-bearing debt / Total equity at fiscal year-end
 デット・エクイティ・レシオ = 有利子負債 ÷ 期末自己資本 × 100 (%)

From FY2007, Equity = Net assets – subscription rights to shares – Minority interests
 2007年3月期より、自己資本 = 純資産 – 新株予約権 – 少数株主持分

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 2. The figure for trade notes and accounts receivable used for calculation of the receivable turnover does not include the figure for non-trade accounts receivable.
 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
 2. 売上債権回転日数の計算の元になる「受取手形及び売掛金」の数字には未収金を含んでいません。
 3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Return on Equity (ROE)

自己資本利益率



FY	ROE (%)
年度	自己資本利益率
2003	(14.8)
2004	3.1
2005	20.3
2006	13.5
2007	21.8
2008	21.4

ROE = (Net income / Average total equity) × 100
自己資本利益率 = 当期利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100 (%)

Return on Assets (ROA)

総資産利益率

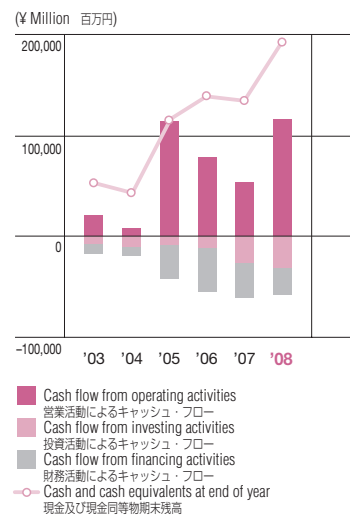


FY	ROA (%)
年度	総資産利益率
2003	0.2
2004	4.1
2005	10.7
2006	11.7
2007	20.2
2008	21.7

ROA = (Operating income + Interest and dividend income) / Average total assets × 100
総資産利益率 = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 期首・期末平均総資産 × 100 (%)

Cash Flows

キャッシュ・フロー

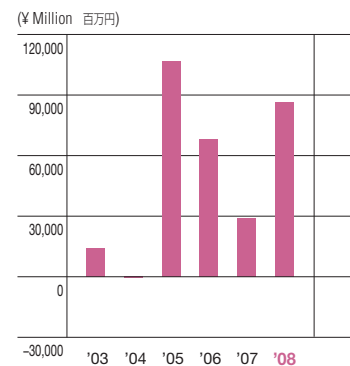


FY	Cash flow from operating activities	Cash flow from investing activities	Cash flow from financing activities	Cash and cash equivalents at end of year
年度	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
2003	21,394	(7,270)	(9,884)	52,982
2004	7,883	(8,544)	(10,271)	42,650
2005	114,350	(7,450)	(34,344)	115,420
2006	78,854	(10,537)	(43,421)	140,024
2007	54,297	(25,293)	(34,719)	134,390
2008	116,939	(30,186)	(27,033)	193,493

For cash and cash equivalents at end of year, please refer to the note on page 17.
現金及び現金同等物期末残高については、17ページの注記をご参照下さい。

Free Cash Flows

フリー・キャッシュ・フロー

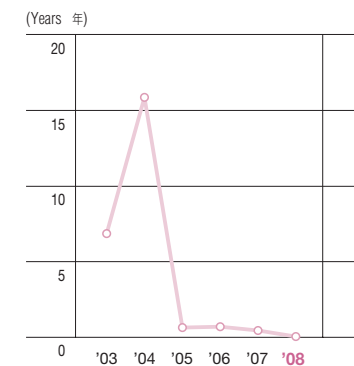


FY	Free cash flows
年度	フリー・キャッシュ・フロー
2003	14,124
2004	(661)
2005	106,900
2006	68,317
2007	29,004
2008	86,753

Free cash flow = Cash flow from operating activities + Cash flow from investing activities
フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー

Redemption of Debt

債務償還年数



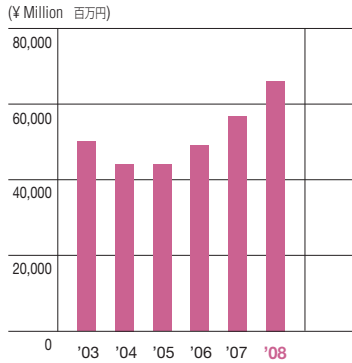
FY	Redemption of debt
年度	債務償還年数
2003	7.1
2004	16.1
2005	0.9
2006	0.8
2007	0.7
2008	0.3

Redemption of debt = Interest-bearing debt / Cash flow from operating activities
債務償還年数 = 有利子負債 ÷ 営業活動によるキャッシュ・フロー

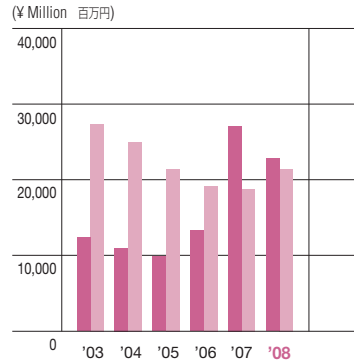
Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

R&D Expenses 研究開発費

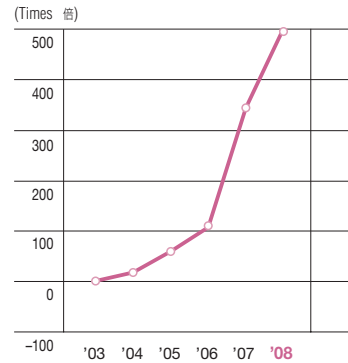


Capital Expenditures and Depreciation Expenses 設備投資額及び減価償却実施額



■ Capital expenditures 設備投資額
■ Depreciation expenses 減価償却実施額

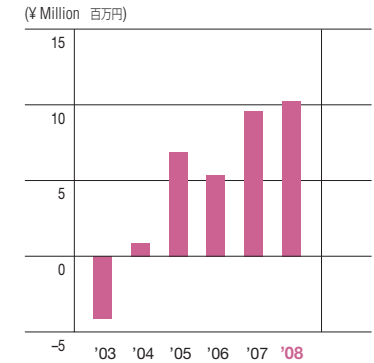
Interest Coverage Ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ



Number of Employees Worldwide 従業員数



Net Income (Loss) per Employee 1人当り当期利益(損失)



FY	(¥ Million 百万円) R&D expenses 研究開発費
2003	50,123
2004	44,150
2005	43,889
2006	49,182
2007	56,962
2008	66,073

FY	Capital expenditures 設備投資額	Depreciation expenses 減価償却実施額
2003	12,359	27,374
2004	11,007	24,963
2005	9,876	21,463
2006	13,335	19,170
2007	27,129	18,820
2008	22,703	21,413

FY	(Times 倍) Interest coverage ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ
2003	0.8
2004	16.9
2005	58.7
2006	111.0
2007	344.4
2008	494.9

FY	(People 人) Number of employees worldwide 従業員数
2003	10,053
2004	8,870
2005	8,864
2006	8,901
2007	9,528
2008	10,429

FY	(¥ Million 百万円) Net income (loss) per employee 1人当り当期利益(損失)
2003	(4.1)
2004	0.9
2005	6.9
2006	5.4
2007	9.6
2008	10.2

Interest coverage ratio = (Operating income + Interest and dividend income) / Interest expenses
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 支払利息 (倍)

Notes: 1. Amortization of goodwill is not included in depreciation expenses.

2. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

注) 1. 減価償却実施額には、のれん償却額は含まれておりません

2. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

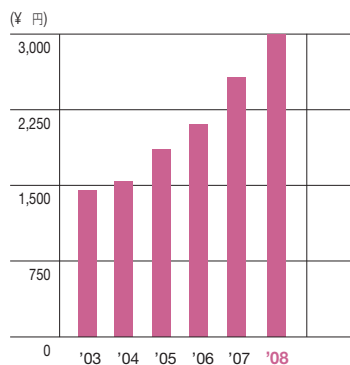
Net Income (Loss) per Share 1株当り当期利益(損失)



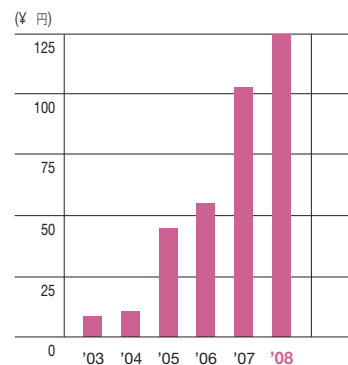
Cash Flow per Share 1株当りキャッシュ・フロー



Net Assets per Share 1株当り純資産



Cash Dividends per Share 1株当り配当金



Payout Ratio 配当性向



FY	Net income (loss) per share
2003	(238.57)
2004	46.37
2005	343.63
2006	267.61
2007	511.27
2008	594.01

FY	Cash flow per share
2003	(81.39)
2004	188.31
2005	465.99
2006	377.08
2007	616.71
2008	713.70

FY	Net assets per share
2003	1,456.23
2004	1,543.73
2005	1,863.28
2006	2,112.30
2007	2,573.72
2008	2,989.70

FY	Cash dividends per share
2003	8.00
2004	10.00
2005	45.00
2006	55.00
2007	103.00
2008	125.00

FY	Payout ratio
2003	—
2004	47.4
2005	23.9
2006	20.6
2007	20.1
2008	21.0

Net income (loss) per share = Net income (loss) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
1株当り当期利益(損失) = 当期利益(損失) ÷ 期中平均発行済株式総数

Cash flow per share = (Net income + Depreciation and amortization) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
1株当りキャッシュ・フロー = (当期利益 + 減価償却費) ÷ 期中平均発行済株式総数

Net assets per share = Net assets / Total number of shares issued
1株当り純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式総数

Payout ratio = Cash dividends per share / Non-consolidated Net income per share × 100
配当性向 = 1株当り配当金額 ÷ 単独1株当り当期純利益 × 100 (%)

- Notes: 1. The payout ratios of FY2003 are not indicated due to net loss on a non-consolidated basis.
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
3. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
4. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
5. The number of shares outstanding excluding the treasury stock is used for calculation of per share data.

- 注) 1. 2003年3月期の配当性向は、単独ベースで当期純損失を計上したため掲載しておりません。
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
3. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
4. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
5. 1株当り指標の計算には自己株式数を控除後の発行済株式数を使用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ASSETS 資産の部											
Current assets 流動資産											
Cash and cash equivalents 現金及び預金	71,057	46,910	79,519	65,320	48,409	52,982	42,650	115,420	140,024	134,390	67,541
Securities 有価証券	835	835	835	—	10	—	—	—	—	20	136,022
Trade notes and accounts receivable 受取手形・売掛金	192,005	140,746	175,153	302,953	167,982	182,218	245,554	172,488	169,038	228,688	224,171
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(1,822)	(1,134)	(1,029)	(1,720)	(620)	(342)	(155)	(114)	(165)	(127)	(63)
Inventories たな卸資産	100,372	88,085	112,481	161,981	127,352	111,810	105,187	161,489	163,746	194,840	161,152
Deferred income taxes 繰延税金資産	—	—	5,306	12,659	3,402	4,152	2,943	18,173	21,356	28,326	24,140
Prepaid expenses and other current assets 前払費用及びその他の流動資産	10,636	15,306	2,892	7,048	6,888	5,619	6,795	27,730	23,489	24,226	27,271
Total current assets 流動資産合計	373,083	290,748	375,157	548,241	353,423	356,439	402,974	495,186	517,488	610,363	640,234
Investments and other assets 投資その他の資産											
Investment securities 投資有価証券	8,020	8,633	9,010	11,599	9,535	7,216	10,874	10,381	14,860	14,643	8,837
Deferred income taxes 繰延税金資産	—	—	2,145	7,394	22,591	9,362	10,203	15,313	13,175	13,691	14,846
Intangible and other assets 無形固定資産及びその他の資産	25,598	23,430	14,367	37,556	36,855	32,273	28,792	25,024	22,982	26,887	24,795
Total investments and other assets 投資その他の資産合計	33,618	32,063	25,522	56,549	68,981	48,851	49,869	50,718	51,017	55,221	48,478
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	—	—	1,094	—	—	—	—	—	—	—	—
Property, plant and equipment 有形固定資産											
Land 土地	13,678	17,163	16,554	19,698	19,908	19,718	19,577	18,351	18,150	20,495	20,729
Buildings 建物及び構築物	73,847	81,527	89,795	106,753	114,586	110,950	108,718	111,119	112,225	121,318	119,578
Machinery and equipment 機械装置・運搬具及び工具器具備品	46,967	62,777	67,520	84,607	95,615	97,937	92,379	90,497	94,764	96,547	99,735
Construction in progress 建設仮勘定	4,181	97	877	853	5,139	2,480	2,552	1,786	2,216	6,062	4,199
Total property, plant and equipment 有形固定資産合計	138,673	161,564	174,746	211,911	235,248	231,085	223,226	221,753	227,355	244,422	244,241
Accumulated depreciation 減価償却累計額	(51,774)	(69,472)	(77,020)	(87,190)	(100,737)	(111,474)	(114,437)	(123,337)	(132,617)	(139,492)	(140,135)
Net property, plant and equipment 有形固定資産合計	86,899	92,092	97,726	124,721	134,511	119,611	108,789	98,416	94,738	104,930	104,106
Total assets 資産合計	493,600	414,903	499,499	729,511	556,915	524,901	561,632	644,320	663,243	770,514	792,818

- Notes: 1. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.
2. Non-trade accounts receivable until FY2004 is included in the trade notes and accounts receivable.
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
5. From FY2008, certificates of deposit that were previously included in cash and cash equivalents are classified as securities.

- 注) 1. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。
2. 2004年3月期までの未収金は、受取手形・売掛金に含めています。
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
5. 2008年3月期より、従来現金及び預金に含めていた譲渡性預金を有価証券に含めて表示しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

Liabilities and Net Assets 負債及び純資産の部**Current liabilities** 流動負債

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Short-term borrowings and commercial paper 短期借入金及びコマーシャルペーパー	56,917	21,657	23,998	78,462	23,924	43,729	6,815	976	2,100	1,712	6,070
Current portion of long-term debt 一年以内返済予定長期借入金及び社債	9,358	1,536	32,699	2,970	26,387	37,404	21,754	35,476	24,500	8,500	30,000
Trade notes and accounts payable 輸入支払手形及び買掛金・未払金	48,734	36,235	62,574	87,350	41,053	48,279	78,009	70,472	75,842	96,847	66,794
Customer advances 前受金	—	—	—	—	—	—	—	42,970	33,811	21,957	24,029
Income taxes payable 未払法人税等	18,818	1,488	11,843	41,440	1,663	3,645	3,273	13,357	22,895	45,657	28,239
Accrued employees' bonuses 賞与引当金	6,507	4,117	7,375	10,948	2,463	3,629	6,376	8,645	10,231	14,131	12,727
Accrued warranty expenses 製品保証引当金	—	—	—	—	—	—	—	13,106	12,219	14,114	9,816
Accrued expenses and other current liabilities 未払費用及びその他の流動負債	4,381	4,022	7,969	17,271	14,012	24,020	25,245	21,609	20,029	22,937	21,146
Total current liabilities 流動負債合計	144,715	69,055	146,458	238,441	109,502	160,706	141,472	206,611	201,627	225,855	198,821
Long-term debt, less current portion 長期借入金及び社債	77,657	77,709	67,278	126,348	105,452	70,230	98,476	63,000	38,500	30,000	—
Accrued pension and severance costs 退職給付引当金	8,362	9,344	11,581	29,807	32,984	36,392	38,275	36,382	38,751	40,686	44,370
Other liabilities その他の固定負債	141	777	545	1,576	1,340	1,074	3,662	1,751	2,743	4,162	4,382
Total liabilities 負債合計	230,875	156,885	225,862	396,172	249,278	268,402	281,885	307,744	281,621	300,703	247,573

Minority interest 少数株主持分**Net assets** 純資産

Common stock 資本金	45,445	45,532	47,163	47,213	47,214	47,223	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961
Capital surplus 資本剰余金	68,507	68,594	70,225	70,275	70,276	70,285	78,023	78,023	78,079	78,347	78,393
Legal reserve 利益準備金	4,228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retained earnings 利益剰余金	142,854	144,715	157,876	214,920	190,195	147,465	154,343	212,094	249,938	328,027	410,867
Treasury stock at cost 自己株式	(25)	(1,125)	(1,661)	(3,519)	(5,015)	(13,239)	(13,203)	(16,043)	(15,117)	(12,168)	(11,370)
Total shareholders' equity 株主資本合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449,167	532,851
Unrealized gains on securities 其他有価証券評価差額金	—	—	—	1,658	1,171	(59)	2,396	2,133	5,118	5,853	2,172
Deferred gains or losses on hedges 繰延ヘッジ損益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(177)	460
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	—	—	—	2,734	3,738	1,229	(720)	997	3,921	5,333	(530)
Total valuation and translation adjustments 評価・換算差額等合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,009	2,102
Share subscription rights 新株予約権	—	—	—	—	—	—	—	—	—	584	484
Minority interests 少数株主持分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,051	9,808
Total net assets 純資産合計	261,009	257,716	273,603	333,281	307,579	252,904	275,800	332,165	376,900	469,811	545,245
Total liabilities and net assets 負債及び純資産合計	493,600	414,903	499,499	729,511	556,915	524,901	561,632	644,320	663,243	770,514	792,818

- Notes: 1. From FY2001, the Company adopts new accounting standards for retirement benefits.
2. Customer advances until FY2004 are included in other current liabilities.
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
5. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

- 注) 1. 2001年3月期から退職給付に係る新しい会計基準を適用しています。
2. 2004年3月期までの前受金は、その他の流動負債に含めています。
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
5. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Net sales 売上高	455,585	313,820	440,729	723,880	417,825	460,580	529,654	635,710	673,686	851,975	906,092
Cost of sales 売上原価	304,825	225,962	303,839	458,902	302,270	326,540	389,499	459,797	483,954	579,326	594,794
Gross profit 売上総利益	150,760	87,858	136,890	264,978	115,555	134,040	140,155	175,913	189,732	272,649	311,298
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	94,237	81,475	101,074	143,892	133,865	132,921	117,875	111,930	114,029	128,670	142,800
Portion of enterprise taxes included in selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費に含まれる事業税	6,773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	56,522	6,383	35,816	121,086	(18,310)	1,119	22,280	63,983	75,703	143,979	168,498
Other income (expenses) その他収益 (費用)	(462)	(345)	(6,127)	(21,954)	(4,609)	(24,129)	(7,344)	(8,208)	(375)	435	722
Interest and dividend income 受取利息及び受取配当金	1,664	898	276	669	351	191	200	236	504	910	1,491
Interest expenses 支払利息	(1,640)	(2,003)	(1,960)	(2,378)	(1,960)	(1,601)	(1,326)	(1,094)	(687)	(421)	(343)
Other その他	(486)	760	(4,443)	(20,245)	(3,000)	(22,719)	(6,218)	(7,350)	(192)	(54)	(426)
Income (loss) before income taxes 税引前当期利益 (損失)	56,060	6,038	29,689	99,132	(22,919)	(23,010)	14,936	55,775	75,328	144,414	169,220
Income taxes 法人税等											
Current 法人税・住民税及び事業税	26,051	4,167	14,545	50,589	2,612	4,806	5,108	15,540	29,189	60,132	56,569
Deferred 法人税等調整額	—	—	(4,709)	(13,490)	(5,602)	13,726	1,016	(21,970)	(2,352)	(7,535)	5,374
Minority interests 少数株主利益	—	5	5	21	8	12	515	604	485	554	1,006
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	30,009	1,866	19,848	62,012	(19,938)	(41,554)	8,297	61,601	48,006	91,263	106,271

Notes: 1. Enterprise taxes, which were included in selling, general and administrative expenses until FY1998, are included in provision for income taxes from FY1999.
2. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.
3. Some of the field engineering expenses of service related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.
4. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
5. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
6. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

注) 1. 事業税について、1998年3月期までは販売費及び一般管理費に含めて表示していましたが、会計基準の変更に伴い、1999年3月期より法人税等に含めて表示しています。
2. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。
3. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費の中に含めていたサービ子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しました。
4. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
5. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
6. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

	(¥ Million 百万円)							
Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Cash flows from operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー								
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益 (損失)	99,132	(22,919)	(23,010)	14,936	55,775	75,328	144,414	169,220
Depreciation and amortization 減価償却費	21,679	26,294	27,374	24,963	21,463	19,170	18,820	21,413
(Increase) decrease in trade notes and accounts receivable 売上債権の増減額	(121,669)	131,251	(13,662)	(61,789)	59,115	5,144	(58,352)	2,473
(Increase) decrease in inventories たな卸資産の増減額	(53,666)	28,359	(3,890)	(5,326)	(59,914)	(5,467)	(31,585)	28,343
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable 仕入債務の増減額	9,709	(34,166)	10,352	29,154	(7,440)	6,743	17,236	(27,373)
Income taxes paid 法人税の支払額	(19,596)	(43,848)	(527)	(6,961)	(4,774)	(19,525)	(37,785)	(73,722)
Other その他	34,969	(7,413)	24,757	12,906	50,125	(2,539)	1,549	(3,415)
Net cash provided by (used in) operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー	(29,442)	77,558	21,394	7,883	114,350	78,854	54,297	116,939
Cash flows from investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー								
Payment for purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	(39,155)	(31,006)	(7,028)	(7,530)	(8,680)	(8,601)	(25,154)	(19,338)
Payment for acquisition of intangible assets 無形固定資産の取得による支出	(4,568)	(5,390)	(2,780)	(3,200)	(1,780)	(2,611)	(2,462)	(4,042)
Payment for purchase of newly consolidated subsidiaries 新規連結子会社の取得による支出	(18,867)	—	—	—	—	—	—	—
Other その他	231	607	2,538	2,186	3,010	675	2,323	(6,806)
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー	(62,359)	(35,789)	(7,270)	(8,544)	(7,450)	(10,537)	(25,293)	(30,186)
Cash flows from financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー								
Increase (decrease) in debt 借入債務の増減額	83,779	(51,682)	(4,012)	(8,624)	(27,618)	(34,439)	(24,904)	(4,148)
Dividends paid 配当金の支払額	(4,733)	(4,030)	(1,395)	(1,409)	(3,743)	(9,796)	(12,843)	(23,431)
Other その他	(1,864)	(1,502)	(4,477)	(238)	(2,983)	815	3,028	546
Net cash provided by (used in) financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー	77,182	(57,214)	(9,884)	(10,271)	(34,344)	(43,420)	(34,719)	(27,033)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 現金及び現金同等物に係る換算差額	391	(1,437)	333	600	214	(341)	81	(617)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の増減額	(14,228)	(16,881)	4,573	(10,332)	72,770	24,556	(5,634)	59,103
Cash and cash equivalents at beginning of year 現金及び現金同等物期首残高	79,519	65,291	48,409	52,982	42,650	115,420	140,024	134,390
Effect of newly consolidated subsidiary 新規連結子会社の影響	—	—	—	—	—	48	—	—
Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高	65,291	48,409	52,982	42,650	115,420	140,024	134,390	193,493

Note: From FY2008, cash and cash equivalents at end of year = cash and cash equivalents described in consolidated balance sheets + securities – certificates of deposit for more than three months.

注) 2008年3月期より、現金及び現金同等物期末残高=連結貸借対照表に掲記されている現金及び預金+有価証券-預入期間3ヶ月超の譲渡性預金

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2002				2003				2004			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Net sales 売上高	116,821	136,301	63,738	100,966	92,307	131,081	96,993	140,199	87,779	133,638	121,235	187,002
Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	91,924	111,958	44,938	76,895	71,276	105,950	75,392	112,072	65,320	106,913	96,497	157,017
FPD Production Equipment FPD製造装置												
Electronic Components 電子部品	20,095	19,950	15,184	18,428	17,369	19,990	18,207	21,813	18,769	21,142	20,620	23,698
Computer Network コンピュータ・ネットワーク	4,384	4,023	3,304	5,320	3,335	4,792	3,095	5,971	3,398	5,245	3,815	5,990
Other その他	418	369	312	322	327	349	299	342	292	338	303	297
Cost of sales 売上原価	78,575	94,373	46,959	82,364	66,273	88,894	66,915	104,459	66,607	98,540	91,462	132,889
Gross profit 売上総利益	38,247	41,928	16,779	18,602	26,035	42,187	30,078	35,740	21,171	35,098	29,773	54,113
Gross profit margin 売上総利益率	32.7%	30.8%	26.3%	18.4%	28.2%	32.2%	31.0%	25.5%	24.1%	26.3%	24.6%	28.9%
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	37,660	30,581	31,643	33,981	32,176	35,544	31,601	33,600	29,465	31,598	25,593	31,219
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	587	11,346	(14,865)	(15,379)	(6,141)	6,643	(1,523)	2,140	(8,294)	3,500	4,180	22,894
Operating margin 営業利益率	0.5%	8.3%	(23.3%)	(15.2%)	(6.7%)	5.1%	(1.6%)	1.5%	(9.4%)	2.6%	3.4%	12.2%
Ordinary income (loss) 経常利益 (損失)	201	10,773	(14,770)	(15,668)	(6,745)	6,043	(1,854)	2,325	(8,741)	3,116	4,041	22,752
Ordinary profit margin 経常利益率	0.2%	7.9%	(23.2%)	(15.5%)	(7.3%)	4.6%	(1.9%)	1.7%	(10.0%)	2.3%	3.3%	12.2%
Income before income taxes (loss) 税引前当期利益 (損失)	890	10,858	(14,614)	(20,054)	(6,264)	5,565	(1,921)	(20,390)	(9,001)	408	3,808	19,721
Ratio of income before income taxes to net sales 税引前当期利益率	0.8%	8.0%	(22.9%)	(19.9%)	(6.8%)	4.2%	(2.0%)	(14.5%)	(10.3%)	0.3%	3.1%	10.5%
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	(3,514)	6,099	(10,681)	(11,843)	(4,172)	1,634	(166)	(38,851)	(10,366)	560	2,751	15,352
Net income margin 当期純利益率	(3.0%)	4.5%	(16.8%)	(11.7%)	(4.5%)	1.2%	(0.2%)	(27.7%)	(11.8%)	0.4%	2.3%	8.2%

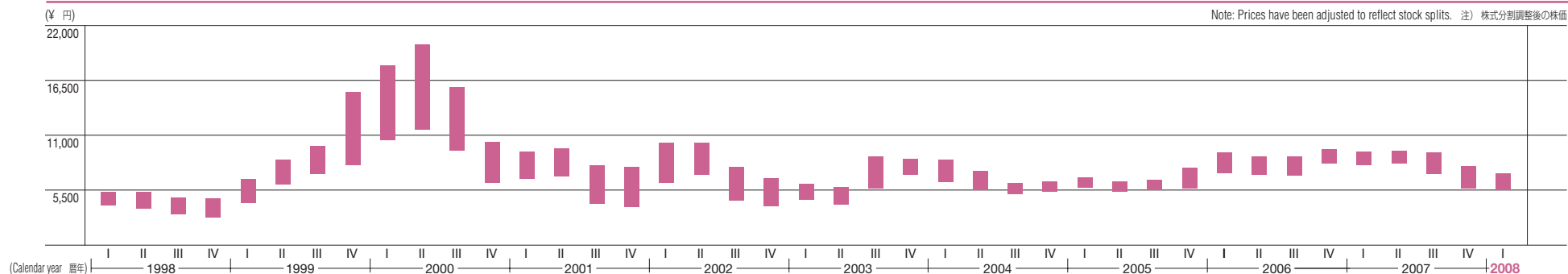
(¥ Million 百万円)

2005					2006				2007				2008			
1Q	1H	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
280,199		149,409	206,102		160,016	173,122	145,059	195,489	179,205	211,358	210,094	251,319	212,494	263,884	199,838	229,876
206,064		102,050	149,077		113,985	125,275	104,569	143,054	125,925	157,980	158,828	199,891	165,785	213,466	160,739	186,449
21,014		25,266	28,757		23,915	19,123	16,663	21,475	28,933	23,636	26,024	22,174	21,400	22,200	10,048	14,368
45,137		18,680	22,432		18,603	23,306	20,274	24,698	21,042	24,012	21,142	22,098	25,176	28,096	28,981	28,929
7,357		3,123	5,486		3,190	5,089	3,289	5,929	3,010	5,439	3,858	6,863				
627		289	349		323	329	263	331	295	291	242	293	133	122	70	130
203,497		106,991	149,309		113,513	130,401	100,141	139,900	124,765	146,406	136,151	172,004	135,908	175,110	127,411	156,365
76,703		42,418	56,793		46,503	42,721	44,918	55,589	54,440	64,952	73,943	79,315	76,586	88,773	72,427	73,512
27.4%		28.4%	27.6%		29.1%	24.7%	31.0%	28.4%	30.4%	30.7%	35.2%	31.6%	36.0%	33.6%	36.2%	32.0%
56,427		25,404	30,099		24,770	28,212	27,956	33,090	28,575	32,576	31,039	36,481	33,552	36,803	33,927	38,518
20,275		17,014	26,694		21,733	14,509	16,961	22,499	25,865	32,376	42,904	42,834	43,035	51,971	38,499	34,994
7.2%		11.4%	13.0%		13.6%	8.4%	11.7%	11.5%	14.4%	15.3%	20.4%	17.0%	20.3%	19.7%	19.3%	15.2%
20,985		17,411	27,238		21,717	15,037	16,966	22,232	26,739	31,465	42,116	43,620	41,176	54,620	39,761	37,156
7.5%		11.7%	13.2%		13.6%	8.7%	11.7%	11.4%	14.9%	14.9%	20.0%	17.4%	19.4%	20.7%	19.9%	16.2%
7,944		17,355	30,477		22,084	14,491	16,984	21,770	27,321	31,174	42,121	43,799	42,484	55,718	40,016	31,002
2.8%		11.6%	14.8%		13.8%	8.4%	11.7%	11.1%	15.2%	14.7%	20.0%	17.4%	20.0%	21.1%	20.0%	13.5%
1,273		13,401	46,928		13,238	10,741	10,148	13,879	16,282	20,943	26,988	27,050	26,193	36,271	25,600	18,207
0.5%		9.0%	22.8%		8.3%	6.2%	7.0%	7.1%	9.1%	9.9%	12.8%	10.8%	12.3%	13.7%	12.8%	7.9%

- Notes: 1. Sales of FPD production equipment until FY2004 are included in the sales of semiconductor production equipment.
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
3. As changes in accounting policies were made in the second quarter (2Q) of FY2005, aggregate figures for the first quarter (1Q) and the second quarter (2Q) of FY2005 are provided.
4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
5. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

- 注) 1. 2004年3月期までのFPD製造装置売上高は、半導体製造装置売上高に含まれています。
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
3. 会計方針の変更が2005年3月期の第2四半期に行なわれたため、2005年3月期の第1四半期と第2四半期の数字につきましては合算にて表示しています。
4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
5. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Stock Price Range 株価の推移



Years ended March 31 各3月31日までの1年間		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
High (¥)	高値 (円)	8,670	6,630	18,000	20,090	10,260	10,280	8,920	7,390	9,270	9,650	9,410
Low (¥)	安値 (円)	3,920	2,755	6,080	6,240	3,820	3,870	4,070	5,110	5,350	6,980	5,540

Note: Prices have been adjusted to reflect stock splits. 注) 株式分割調整後の株価

PER (Times)	High	株価収益率 (倍)	最高	49.6	619.6	158.5	56.8	—	—	192.4	21.5	34.6	18.9	15.8
	Low		最低	22.4	257.5	53.6	17.6	—	—	87.8	14.9	20.0	13.7	9.3
PBR (Times)	High	株価純資産倍率 (倍)	最高	5.8	4.5	11.5	10.6	5.8	7.1	5.8	4.0	4.4	3.7	3.1
	Low		最低	2.6	1.9	3.9	3.3	2.2	2.7	2.6	2.7	2.5	2.7	1.9
PCFR (Times)	High	株価キャッシュ・フロー倍率 (倍)	最高	34.9	58.4	80.1	42.1	282.6	—	47.4	15.9	24.6	15.6	13.2
	Low		最低	15.8	24.3	27.1	13.1	105.2	—	21.6	11.0	14.2	11.3	7.8

Price / earnings ratio = Common stock price / Net income per share 株価収益率 = 株価 ÷ 1株当り当期純利益

Price / book value ratio = Common stock price / Net assets per share 株価純資産倍率 = 株価 ÷ 1株当り純資産

Price / cash flow ratio = Common stock price / Cash flow per share 株価キャッシュ・フロー倍率 = 株価 ÷ 1株当りキャッシュ・フロー

Number of Shares Issued (Fiscal Year-End) 発行済株式数の推移 (期末)

FY 年度		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Number of shares issued (Thousands) 発行済株式数 (千株)		174,569	174,624	175,660	175,691	175,691	175,698	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611
Market capitalization (¥ Billion) 時価総額 (十億円)		783.8	1,070.4	2,722.7	1,454.7	1,583.0	815.2	1,255.2	1,103.5	1,466.6	1,488.2	1,094.5

Market capitalization = Closing stock price at fiscal year-end × Number of shares issued 時価総額 = 期末株式終値 × 発行済株式数

Public Offering of Common Stock 公募増資の実績

Public Offering of Common Stock 有償・公募

Date of issue 発行年月日	Subscribed shares (Thousands) 発行株式数 (千株)	Issuing price (¥) 発行価格 (円)
June 2, 1980	1,980年6月2日	4,131
July 1, 1981	1981年7月1日	2,000
October 16, 1982	1982年10月16日	4,000
May 6, 1983	1983年5月6日	20
June 23, 1984	1984年6月23日	3,000
November 15, 1989	1989年11月15日	6,000

Stock Splits 株式分割

Date of issue 発行年月日	Ratio of distribution 分割比率	
October 1, 1980	1980年10月1日	1:1.25
October 1, 1981	1981年10月1日	1:1.3
November 20, 1982	1982年11月20日	1:1.3
February 1, 1983	1983年2月1日	1:2.0
November 20, 1984	1984年11月20日	1:1.2
November 15, 1989	1989年11月15日	1:1.1
November 15, 1990	1990年11月15日	1:1.2
May 20, 1997	1997年5月20日	1:1.1

Major Shareholders (Top 10) 大株主一覧 (上位10位)

As of March 31, 2008 2008年3月31日現在

Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 日本マスタートラスト信託銀行 (信託口)	19,052	10.54
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口)	14,423	7.98
Tokyo Broadcasting System, Inc. 東京放送	8,727	4.83
The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company. 第一生命保険相互会社	4,800	2.65
Deutsche Securities Inc. ドイツ証券	4,347	2.40

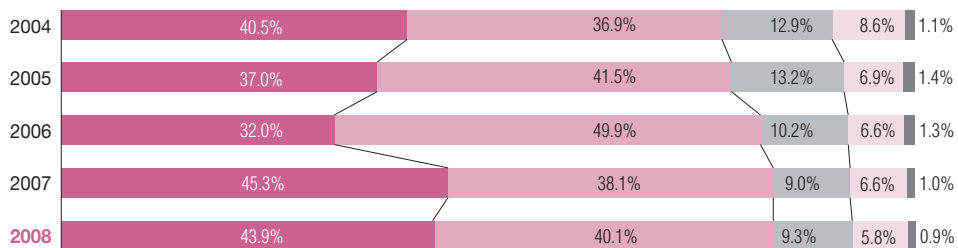
Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
Nomura Securities Co., Ltd. 野村證券	4,183	2.31
Trust & Custody Services Bank, Ltd.(trust account) 資産管理サービス信託銀行 (証券投資信託口)	3,488	1.93
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 4) 日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口4)	3,021	1.67
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 三菱東京UFJ銀行	3,000	1.66
BNP Paribas Securities(Japan) Ltd. ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド (ビーエヌピー・パリバ証券会社)	2,790	1.54

Composition of Shareholders by Category 所有者別分布状況

As of March 31, 2008 2008年3月31日現在

Category 区分	2004			2005			2006			2007			2008		
	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比		
Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社	232	73,221	40.5%	207	66,817	37.0%	202	57,748	32.0%	256	81,793	45.3%	262	79,240	43.9%
Foreign institutions and others 外国法人等	571	66,604	36.9%	553	74,864	41.5%	600	90,081	49.9%	623	68,775	38.1%	639	72,365	40.1%
Japanese individuals and others 個人・その他	59,361	23,251	12.9%	59,415	23,902	13.2%	44,930	18,408	10.2%	39,837	16,247	9.0%	41,871	16,739	9.3%
Other Japanese corporations その他の法人	708	15,513	8.6%	681	12,498	6.9%	539	12,037	6.6%	572	11,983	6.6%	551	10,588	5.8%
Treasury stock 自己株式	1	2,022	1.1%	1	2,530	1.4%	1	2,336	1.3%	1	1,813	1.0%	1	1,679	0.9%
Total 合計	60,873	180,611	100.0%	60,857	180,611	100.0%	46,272	180,611	100.0%	41,289	180,611	100.0%	43,324	180,611	100.0%

Number of shareholders and shares includes number of odd lot shareholders and odd lot shares.
株主数及び株式数は、単元未満株主数及び単元未満株式数を含んでいます。



■ Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社
■ Foreign institutions and others 外国法人等
■ Japanese individuals and others 個人・その他
■ Other Japanese corporations その他の法人
■ Treasury stock 自己株式



TOKYO ELECTRON LIMITED

World Headquarters

Akasaka Biz Tower
3-1, Akasaka 5-chome
Minato-ku, Tokyo 107-6325, Japan
Tel: +81-3-5561-7000
Fax: +81-3-5561-7400
URL: <http://www.tel.com>

Investor Relations

Corporate Communications Dept.

Tel: +81-3-5561-7003
Fax: +81-3-5561-7400



Printed on recycled paper.
本誌は再生紙を使用しています。

Printed in Japan
PR46-133